5

15

20

25

30

PCT/EP2004/005136

MAP20 Racid PCT. PTO 15 DEC 2000

Boîtier, notamment boîtier destiné à contenir un circuit imprimé ou similaire et procédé pour l'obtention de celui-ci

La présente invention concerne un boîtier, notamment un boîtier destiné à contenir un circuit imprimé (appelé aussi en anglais Printed Circuit Board ou PCB) ou similaire, et un procédé pour l'obtention de celui-ci.

Il est connu, notamment dans le domaine de l'électronique, d'utiliser un boîtier à l'intérieur duquel se trouvent des composants électroniques placés sur un circuit imprimé. Ce boîtier comporte un couvercle qui peut être constitué éventuellement par le circuit imprimé. Le couvercle est vissé sur le boîtier de manière à venir fermer celui-ci de manière réversible. Souvent, les vis utilisées sont des vis générant elles-mêmes leur taraudage lors du vissage, telles que des vis autotaraudeuses ou autoformeuses. Lors de leur vissage, des copeaux sont produits et ceux-ci tombent à l'intérieur du boîtier, la vis étant introduite depuis l'extérieur de celui-ci. Les copeaux ainsi réalisés tombent parfois sur le circuit imprimé. Ils peuvent alors créer entre les pattes des composants électroniques se trouvant sur le circuit imprimé, ou entre deux pistes de ce circuit, un court-circuit. Ainsi un copeau peut rendre un dispositif électronique inutilisable.

Les composants étant maintenant implantés sur les circuits imprimés de plus en plus près les uns des autres, les problèmes de courts-circuits créés par des copeaux sont de plus en plus fréquents et deviennent donc de moins en moins admissibles. La présente invention a alors pour but de fournir un boîtier qui, par sa conception, empêche un copeau d'atteindre le circuit imprimé destiné à prendre place à l'intérieur de celui-ci. De préférence, le boîtier proposé ne présente pas de surcoût sensible par rapport à un boîtier de l'art antérieur.

A cet effet, elle propose un boîtier, notamment boîtier destiné à contenir des composants électroniques ou similaires, comportant un appui présentant un alésage pour recevoir une vis de fixation.

Selon l'invention, ce boîtier comporte en outre, face à l'alésage pour recevoir la vis, un réceptacle s'étendant à l'intérieur du boîtier.

De cette manière, les copeaux formés lors du premier vissage de la vis dans son alésage sont collectés dans le réceptacle et ne peuvent pas venir polluer les composants électroniques à l'intérieur du boîtier.

De préférence, le réceptacle s'étend depuis l'appui présentant l'alésage et forme avec cet appui, à l'exception de la zone où se trouve l'alésage, un espace fermé. Une fois la vis en place, les copeaux sont ainsi parfaitement enfermés et ne peuvent donc créer de courts-circuits au niveau des composants.

Le réceptacle est par exemple obtenu par emboutissage. Il présente, dans

une forme de réalisation préférentielle, une forme générale tubulaire, de section circulaire et fermée à son extrémité opposée à l'alésage.

L'appui issu du boîtier présentant l'alésage peut se présenter sous la forme d'une languette repliée par rapport à une paroi du boîtier. Alors, avantageusement, le réceptacle est porté par une patte repliée sur la languette.

La présente invention concerne également un flan de tôle découpé et embouti, caractérisé en ce qu'il présente :

- une languette sensiblement rectangulaire, rattachée par un premier côté, sur sensiblement toute sa longueur, au reste du flan de tôle,
 - un alésage réalisé dans la languette,
 - une patte reliée à la languette par un côté voisin du premier côté, et
 - un réceptacle obtenu par un emboutissage réalisé au niveau de la patte.

Un tel flan de tôle permet de réaliser un boîtier selon l'invention à partir d'une seule pièce de métal. Pour faciliter la réalisation du boîtier, et notamment le pliage de la patte, une découpe sensiblement rectangulaire est avantageusement prévue entre la patte et la languette de manière à former une charnière.

La présente invention propose également un procédé de réalisation d'un boîtier, dans lequel un flan de tôle est découpé puis plié, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

20

25

30

5

10

15

- réalisation d'un flan de tôle tel que décrit ci-dessus,
- pliage à plat de la patte sur la languette, et
- pliage à angle droit de la languette par rapport au flan de tôle,

les deux dernières étapes pouvant être réalisées selon un ordre indifférent.

Des détails et avantages de la présente invention ressortiront mieux de la description qui suit, faite en référence au dessin schématique annexé sur lequel :

La figure 1 est une vue partielle d'un boîtier selon l'invention au niveau d'une vis de fixation,

La figure 2 est une vue en coupe selon la ligne de coupe II-II de la figure 4,

La figure 3 est une vue de face des éléments représentés sur la figure 1.

La figure 4 est une vue selon la ligne de coupe IV-IV de la figure 3,

La figure 5 est une vue de dessus de la découpe d'un flan de tôle pour obtenir la partie représentée sur la figure 1, et

La figure 6 est une vue en coupe selon une ligne de coupe VI-VI de la figure 5.

35

La figure 1 montre, vue de dessous, la fixation d'un couvercle 2 sur un boîtier 4. Le couvercle 2 peut être un couvercle en tôle, ou en toute autre matière, ou bien il peut

WO 2004/114735 PCT/EP2004/005136

3

également s'agir d'un circuit imprimé. Les composants fixés sur ce circuit imprimé se trouvent alors orientés vers l'intérieur du boîtier lorsque ce circuit imprimé est fixé sur le boîtier 4. Sur les figures 2 à 4, on remarque une vis 6 pour le maintien du couvercle 2 sur le boîtier 4. Il s'agit ici de préférence d'une vis autoformeuse qui permet une excellente fixation sans l'utilisation d'un écrou.

Sur les figures 1 à 4 du dessin, on voit une partie d'une paroi latérale 8 du boîtier 4. Le couvercle 2 est positionné perpendiculairement à cette paroi latérale 8. Pour permettre la fixation du couvercle 2, la paroi latérale 8 comporte une languette 10 d'une seule pièce avec la paroi latérale 8 et repliée par rapport à cette paroi à angle droit vers l'intérieur du boîtier. Dans cette languette 10 est réalisé un alésage 12 pour recevoir la vis autoformeuse 6. On prévoit, de manière connue, que cet alésage est de diamètre moindre que le diamètre de la tige de la vis 6. Ainsi, de manière connue, la vis 6 vient, lorsqu'elle est vissée dans l'alésage 12, déformer la languette 10 autour de l'alésage 12 de manière à former un taraudage dans la languette 10.

10

15

20

25

30

35

La languette 10 porte un réceptacle 14. Celui-ci est de forme sensiblement cylindrique circulaire et est tubulaire. Il s'étend perpendiculairement au plan de la languette 10 (elle-même parallèle au couvercle 2). Le réceptacle 14 repose sur la languette 10. Il est ouvert du côté de cette languette 10 et est fermé à son extrémité opposée. La paroi de fond 16, c'est à dire celle se trouvant à l'opposé de la languette 10, est par exemple de forme hémisphérique. Le bord du réceptacle, du côté de la languette 10, vient entourer l'alésage 12 réalisé dans cette languette 10. Le réceptacle 14 crée ainsi un espace fermé qui a pour seule ouverture l'alésage 12 et qui est entièrement fermé lorsqu'une vis 6 se trouve dans cet alésage.

Le réceptacle 14 est formé sur une patte 18 ne formant qu'une seule pièce avec la languette 10. Cette patte 18 est repliée à 180° par rapport à la languette 10. La patte 18 est reliée à la languette 10 par deux fines bandes de métal formant une charnière 20. Le réceptacle 14 et sa paroi de fond 16 sont par exemple obtenus par emboutissage de la patte 18.

La languette 10 et le réceptacle 14 peuvent avantageusement ne former qu'une seule pièce avec la paroi 8 du boîtier 4. Par découpe, emboutissage et pliage on obtient la languette 10 pour la fixation de la vis 6 et le réceptacle 14 servant de piège à copeaux pour les copeaux produit lors du premier vissage de la vis 6 autoformeuse dans son alésage 12. La figure 5 montre après découpe et avant pliage le détail d'une tôle utilisée pour réaliser le boîtier 4 représenté sur les figures 1 à 4. On reconnaît sur cette figure 5 la paroi 8, la languette 10 dans laquelle est réalisé l'alésage 12, la patte 18 portant le réceptacle 14 et reliée à la languette 10 par la charnière 20. La languette 10 est

10

15

20

25

30

rattachée à la paroi 8. La patte 18 est quant à elle rattachée à la paroi 8 uniquement par l'intermédiaire de la languette 10 et de la charnière 20. Pour réaliser cette dernière, le flan de tôle utilisé pour réaliser le boîtier 4 présente une découpe rectangulaire 22 séparant la languette 10 de la patte 18. L'emboutissage formant le réceptacle 14 peut être réalisé immédiatement avant la découpe de la tôle. Cette opération se fait sur une même presse avec un outil adapté. Une fois la découpe réalisée, deux pliages sont réalisés successivement. La patte 18 est repliée de 180° autour d'une premier axe de pliage 24 puis l'ensemble formé par la patte 18 et la languette 10 est plié de 90° autour d'un second axe de pliage 26 pour être rabattu vers l'intérieur du boîtier 4. On réalise ainsi, quasiment sans surcoût par rapport à un boîtier classique qui comporte une languette mais pas de patte munie d'un réceptacle, un piège à copeaux qui garantit qu'aucun copeau issu du vissage de la vis 6 dans l'alésage 12 ne vient polluer les composants électroniques se trouvant à l'intérieur du boîtier 4. On peut ainsi éviter tout problème de courts-circuits entre les pattes des composants ou les pistes du circuit imprimé. Ceci se réalise sans rajouter de nouvelles pièces et quasiment sans surcoût par rapport aux boîtiers de l'art antérieur.

La présente invention ne se limite pas à la forme de réalisation préférentielle décrite ci-dessus à titre d'exemple non limitatif. Elle concerne également toutes les variantes de réalisation à la portée de l'homme du métier dans le cadre des revendications ci-après.

Ainsi par exemple, la languette 10 et la patte 18 ne sont pas nécessairement placées sur un bord de la paroi latérale 8, mais peuvent être obtenues à tout endroit de celle-ci, en formant une découpe de ladite paroi 8 sur la périphérie de l'ensemble languette 10 et patte 18, à l'exception du coté de la languette 10 correspondant au second axe de pliage 26.

De plus, la forme du réceptacle peut être différente de celle décrite. Le procédé d'obtention peut lui aussi être différent. On peut en effet prévoir un réceptacle constitué d'une pièce distincte du boîtier. Par exemple dans le cas d'un boîtier pour la réalisation duquel des opérations de soudure sont nécessaires, on peut prévoir de venir souder une pièce au niveau d'un alésage destiné à recevoir une vis autoformeuse de manière à former le piège à copeaux.

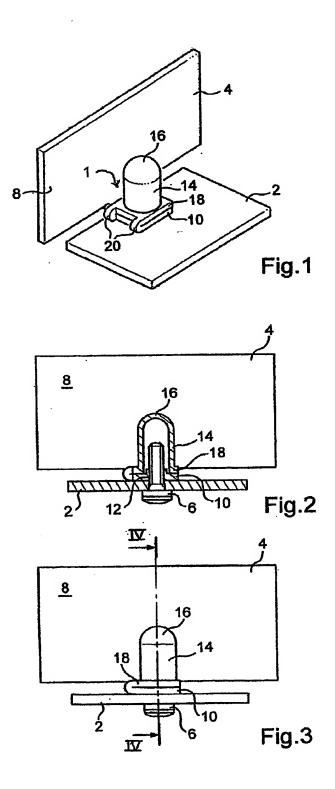
15

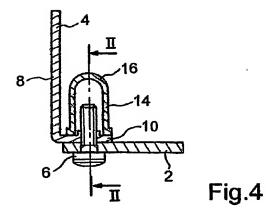
25

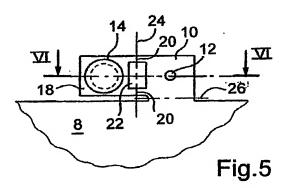
REVENDICATIONS

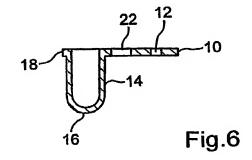
- 1. Boîtier (4), notamment boîtier (4) destiné à contenir des composants électroniques ou similaires, comportant un appui (1) présentant un alésage (12) pour recevoir une vis de fixation (6), caractérisé en ce qu'il comporte en outre, face à l'alésage (12) pour recevoir la vis (6), un réceptacle (14) s'étendant à l'intérieur du boîtier.
- 5 2. Boîtier selon la revendication 1, caractérisé en ce que le réceptacle (14) s'étend depuis l'appui (1) présentant l'alésage (12) et forme avec cet appui (1), à l'exception de la zone où se trouve l'alésage (12), un espace fermé.
 - 3. Boîtier selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le réceptacle (14) est obtenu par emboutissage.
- 10 4. Boîtier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le réceptacle (14) présente une forme générale tubulaire, de section circulaire et fermée à son extrémité opposée à l'alésage (12).
 - 5. Boîtier selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'appui (1) présentant l'alésage (12) se présente sous la forme d'une languette (10) repliée par rapport à une paroi (8) du boîtier.
 - 6. Boîtier selon la revendication 5, caractérisé en ce que le réceptacle (14) est porté par une patte (18) repliée sur la languette (10).
 - 7. Flan de tôle découpé et embouti, caractérisé en ce qu'il présente :
- une languette (10) sensiblement rectangulaire, rattachée par un premier côté, sur
 sensiblement toute sa longueur, au reste du flan de tôle,
 - un alésage (12) réalisé dans la languette (10),
 - une patte (18) reliée à la languette (10) par un côté voisin du premier côté, et
 - un réceptacle (14) obtenu par un emboutissage réalisé au niveau de la patte (18).
 - 8. Flan de tôle selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il présente une découpe (22) sensiblement rectangulaire réalisée entre la patte (18) et la languette (10) de manière à former une chamière (20).
 - 9. Procédé de réalisation d'un boîtier 4, dans lequel un flan de tôle est découpé puis plié, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
 - réalisation d'un flan de tôle selon l'une des revendications 7 ou 8,
- 30 pliage à plat de la patte (18) sur la languette (10), et
 - pliage à angle droit de la languette (10) par rapport au flan de tôle,
 les deux dernières étapes pouvant être réalisées selon un ordre indifférent.

1/2









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PS/EP2004/005136

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H05K5/00					
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED					
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classificati H05K	ion symbols)				
110	nook					
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are inclu-	ded in the fields searched			
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data be	se and. where practical	search terms used)			
	ternal, WPI Data, PAJ	,	,			
	osimary in a base, the					
[
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rel	levant passages	Relevant to claim No.			
						
Α	DE 37 36 986 A (GRUNDIG EMV)		}			
	11 May 1989 (1989-05-11)		ļ			
	the whole document					
Α	DE 87 05 154 U (SIEMENS AG)					
,	4 August 1988 (1988-08-04)		}			
	the whole document					
Α	DE 195 48 205 C (BOPLA GEHAEUSE S	SYSTEME	1			
	GMBH) 16 January 1997 (1997-01-16					
	the whole document		İ			
Α	US 2002/112870 A1 (KORAVASHI TOSI	HIKI ET	į			
^	US 2002/112870 A1 (KOBAYASHI TOSHIKI ET AL) 22 August 2002 (2002-08-22)					
	figures 1,7,13					
		•				
Furti	ner documents are tisted in the continuation of box C.	X Patent family m	embers are listed in annex.			
° Special ca	tegories of cited documents :		shed after the international filing date			
"A" docums consid	'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the					
"E" earlier o	considered to be or particular relevance threation E' earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention					
	Thing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone					
dtalior	n or other special reason (as specified)	cannot be consider				
other r	*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled					
"P" document published prior to the international filing date but in the art. later than the priority date claimed "a" document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report						
4	August 2004	30/09/20	004			
Name and n	Name and mailing address of the ISA Authorized officer					
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk					
	Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Batev, P					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No EP2004/005136	
/EP2004/005136	

Patent document cited in search report	1	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 3736986	Α	11-05-1989	DE	3736986	A1	11-05-1989
DE 8705154	υ	04-08-1988	DE	8705154	U1	04-08-1988
DE 19548205	С	16-01-1997	DE	19548205	C1	16-01-1997
US 2002112870	A1	22-08-2002	JP JP DE US	2001085858 2001085866 10045728 6407925	A A1	30-03-2001 30-03-2001 22-03-2001 18-06-2002

Form PCT/ISA/210 (petent family ennex) (January 2004)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No PCT/EP2004/005136

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H05K5/00					
Selon la clas	sification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	dion nationale et la CIB			
	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	a classament)			
CIB 7	ion minimate consultée (système de classification suivi des symboles de H05K	e classement)			
Documentat	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où d	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche		
Base de don	nées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	om de la base de données, et si réalisat	ele, termes de recherche utilisés)		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		-		
	CONSTRUCTION OF THE PROTECTION				
Catégorie °	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication d	es passages pertinents	no. des revendications visées		
Carogonio					
Α	DE 37 36 986 A (GRUNDIG EMV)				
	11 mai 1989 (1989-05-11) le document en entier				
	te document en entre				
Α	DE 87 05 154 U (SIEMENS AG)				
	4 août 1988 (1988-08-04) le document en entier				
		CTCMC			
Α	DE 195 48 205 C (BOPLA GEHAEUSE SY GMBH) 16 janvier 1997 (1997-01-16)	STEME			
	le document en entier				
A	US 2002/112870 A1 (KOBAYASHI TOSHI	KI ET			
,	AL) 22 août 2002 (2002-08-22)				
	figures 1,7,13				
	·				
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	χ Les documents de familles de bro	evets sont Indiqués en annexe		
° Catégories	a unidate lan de decumente ell'acc		- d- data barrational and		
	ent définissant l'état général de la technique, non	 document uitérieur publié après la dat date de priorité et n'appartenenant pu technique pertinent, mais cité pour co 	as à l'état de la l		
consid	léré comme particulièrement pertinent	ou la théorie constituant la base de l' document particulièrement pertinent; l	invention		
ou apr	ès cette date ^ int pouvant leter un doute sur une revendication de	être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document co	comme impliquant une activité 💎 🛚		
autre e	citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee)	document particulièrement pertinent; l ne neut être considérée comme impl	'inven tion revendiquée iquant une activité inventive		
une ex	ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à cposition ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à un documents de même nature, cette co pour une personne du métier	n ou plusieurs autres ombinaison étant évidente		
"P" docume postér	ent publié avant la date de dépôt international, mais leurement à la date de priorité revendiquée '8	document qui fait partie de la même fa	amilie de brevets		
Date à laqu	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport	de recherche Internationale		
4	août 2004	30/09/2004			
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé			
	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Ripswijk Tel (231-70) 320-2040 TV 31 851 ero pl	Datau D			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Batev, P				

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renselgnemier relatifier x membres de familles de brevets

Personde Internationale No Per/EP2004/005136

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 3736986	Α	11-05-1989	DE	3736986 A1	11-05-1989
DE 8705154	U	04-08-1988	DE	8705154 U1	04-08-1988
DE 19548205	С	16-01-1997	DE	19548205 C1	16-01-1997
US 2002112870	A1	22-08-2002	JP JP DE US	2001085858 A 2001085866 A 10045728 A1 6407925 B1	30-03-2001 30-03-2001 22-03-2001 18-06-2002

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (Janvier 2004)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.